

Datenblatt Herstellung Leiterplatten, IMS Aluminium

Basismaterialien	Materialstärke	1,0 / 1,5 / 2,0 mm
	min. Kupfer-Dicke	35 µm
	max. Kupfer-Dicke	105 µm
	T _g	130 °C
	Wärmeleitfähigkeit	1,0 / 1,5 / 2,2 W/ mK
Layout	Strukturbreite	125 µm
	Strukturabstand	125 µm
	uml. Löstoplack-Freistellung	50 µm
	kleinster Löstoplack-Steg	150 µm
	kleinster Fräsradius	1000 µm
	kleinster Ritzwinkel	30 °
Oberfläche	HAL bleifrei	
	HAL SnPb	
	chem. Zinn	
	chem. Ni/Au	
	chem. Ag	
Löstopplack	grün / schwarz / blau / rot ...	
	superweiß (für LED- Anwendungen)	
	abziehbare Lötdeckmaske	
	Kaptonband, hitzebeständig bis 260°C	
Kennzeichendruck	weiß / gelb / schwarz ...	
Qualitätskontrolle	optische Kontrolle	
	AOI	
	elektrischer Test	
	Erstmusterprüfung	
Daten	vorzugsweise Gerberdaten	
	Eagle	
	TARGET, PROTEL, Altium, etc.	
Zertifikate / Normen	ISO 9001:2015	
	IPC-A-600	
andere Ausführungen auf Anfrage		